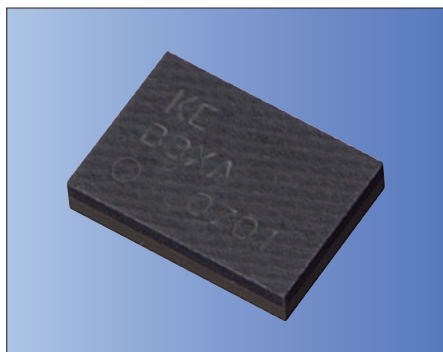


Bluetooth™ MODULES

Bluetooth™ HCIモジュール FB03UAXシリーズ



RoHS対応品

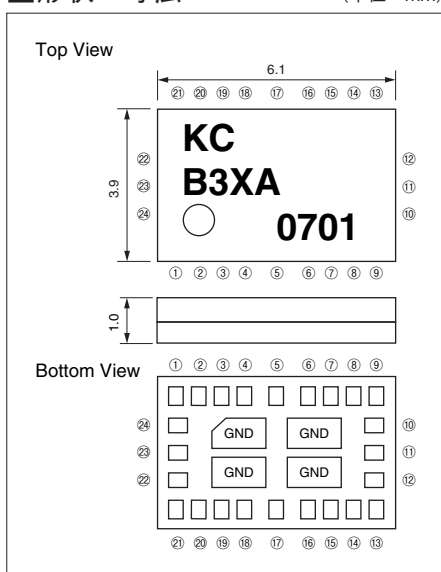
■特長

- ICチップセット：BCM2046
- 6.1×3.9×1.0mmの小型サイズ
- 幅広い使用温度範囲（-20～+70°C）
- 水晶振動子内蔵
- Ver 2.1+EDR対応
- Class 2

※BluetoothはBluetooth SIG Inc.の登録商標です。

■形状・寸法

（単位：mm）



●ピン配列

①	VDDRF
②	VDDC
③	VREGIN
④	EXT_LPO
⑤	VDDTF
⑥	HOST_WAKE
⑦	WLAN_ACTIVITY
⑧	UART_TXD
⑨	UART_RXD
⑩	PCM_SYNC
⑪	PCM_OUT
⑫	BT_PRIORITY/
⑬	LINK_IND/STATUS
⑭	PCM_CLK
⑮	VDDO
⑯	PCM_IN
⑰	GND
⑱	UART_CTS
⑲	UART_RTS
⑳	BT_WAKE
㉑	GND
㉒	RF OUT

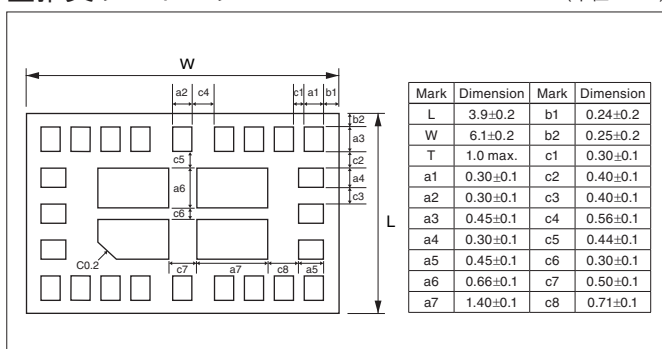
㉓	RST_N
㉔	VREGCTL

■規格

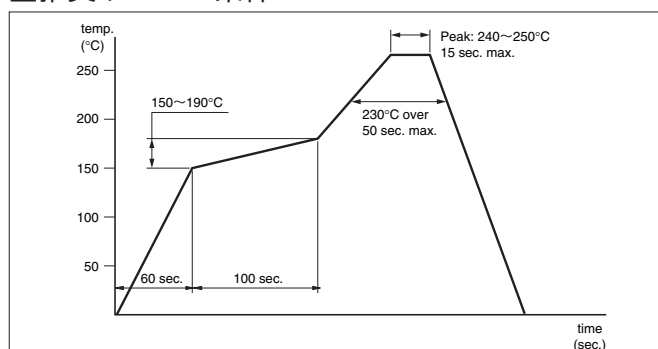
	Unit	min.	typ.	max.
Power Supply VDD	V	1.7	—	3.6
Ambient Temperature	°C	-20	25	70
Receiver RF Specifications RCV/ CA/ 02/ C (Sensitivity-Multi Slot Packets) DH5	dBm	—	-84	-72
Transmitter RF Specifications TRM/ CA/ 01/ C (Output Power) Class 2 Pave	dBm	-6	—	4

■推奨ランドパターン

（単位：mm）

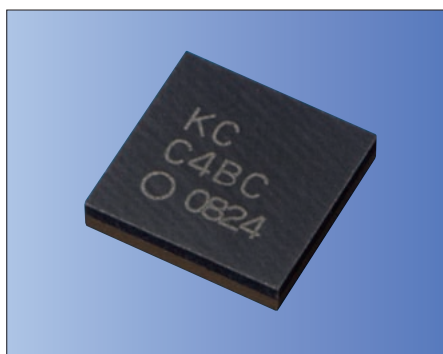


■推奨リフロー条件



Bluetooth™ MODULES

Bluetooth™ HCIモジュール FC04UABシリーズ



RoHS対応品

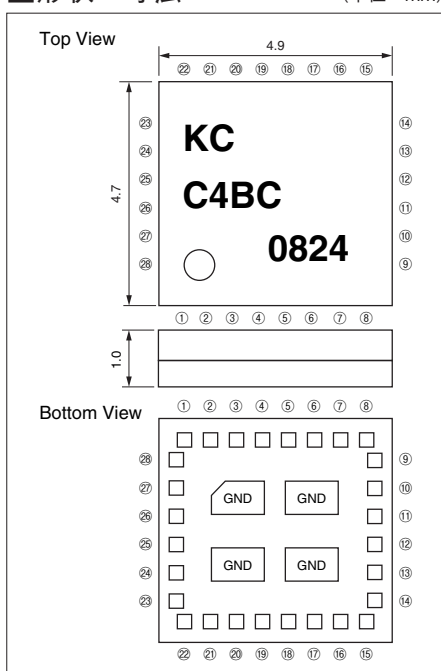
■特長

- ICチップセット：BC4-ROM CSP搭載
- 4.9×4.7×1.0mmの小型サイズ
- 幅広い使用温度範囲（-20～+85°C）
- Ver 2.0対応
- Class 2

※BluetoothはBluetooth SIG Inc.の登録商標です。

■形状・寸法

（単位：mm）



●ピン配列

①	UART_RX
②	GND
③	RF-OUT
④	GND
⑤	PIO_0
⑥	PIO_1
⑦	PIO_2
⑧	PIO_3
⑨	PIO_4
⑩	PIO_5
⑪	PIO_6
⑫	PIO_7
⑬	PIO_8
⑭	PIO_9
⑮	PIO_10
⑯	RESETB
⑰	CAP
⑱	PCM_IN
⑲	PCM_CLK
⑲	PCM_SYNC
⑲	PCM_OUT
⑲	VREG_IN

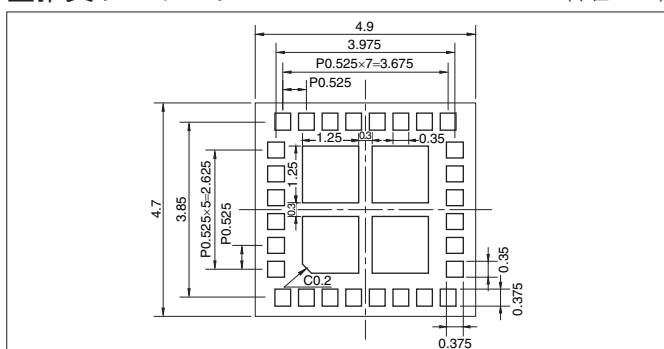
⑳	XTAL_IN
㉑	XTAL_OUT
㉒	VDD
㉓	UART_RTS
㉔	UART_TX
㉕	UART_CTS

■規格

	Unit	min.	typ.	max.
Power Supply VDD	V	1.7	—	3.6
Ambient Temperature	°C	-20	25	85
Receiver RF Specifications RCV/ CA/ 02/ C (Sensitivity-Multi Slot Packets) DH5	dBm	—	-80	-72
Transmitter RF Specifications TRM/ CA/ 01/ C (Output Power) Class 2 Pave	dBm	-6	—	4

■推奨ランドパターン

（単位：mm）



■推奨リフロー条件

